

## MODIFIED EPOXY

세뉴폰 4360  
(철 구조물)



### 1. 표면처리 (철재)

- 1) 표면의 유분의 오염물은 희석제 #001 또는 #003 으로 제거합니다. : SSPC-SP 1.
- 2) 표면 녹 제거는 블라스트 처리로 준나금속면(SSPC-SP 6) 수준으로 처리를 하여 주시고 이때 표면조도는 40~75 마이크론 정도가 적합합니다.
- 3) 구 도막이 잔존하는 경우 당사의 추천에 따릅니다.
- 4) 표면의 유분, 염분, 수분, 먼지 등 기타 이물질이 제거된 상태이어야 합니다.
- 5) 표면의 먼지는 진공청소기 또는 건조된 고압공기를 이용하여 제거하여 주십시오.

### 2. 도장 전 준비사항

#### 1) 표면처리

- 표면의 유분, 염분, 수분, 먼지 등 기타 이물질이 제거된 상태이어야 합니다.
- 도장사양에 의해 추천된 하도를 평활하게 한 후 도장을 합니다.
- 도막에 부분적 결함 발생 시 세뉴폰 4360 으로 터치업 도장 후 후속도장을 실시합니다.

#### 2) 도장 조건

NO.	점검 사항	구비 조건		
		최저	최대	보통
1	도료의 온도	5℃	32℃	15~30℃
2	피도면의 온도	5℃	52℃	15~30℃
3	대기온도	5℃	43℃	16~32℃
4	상대습도	0%	95%	30~80%
5	이슬점	피도면 온도보다 3℃ 이상 낮을 것		

### 3. 도장 절차

#### 1) 도료의 혼합

- 주제(PART A)와 경화제(PART B)로 형성된 2액형 도료로 혼합비율 부피비 1 : 1 로 균일하게 혼합하여야 합니다.
- 혼합 방법은 동력 교반기를 사용하는 것이 원칙입니다.

#### 2) 가사시간

- 25℃ 기준 최대 2시간이며, 온도가 높을수록 가사시간은 짧아집니다.
- 혼합 후 가사시간이 경과한 도료는 사용을 금합니다.
- 온도 별 가사시간은 다음과 같습니다.

온도	10℃	20℃	25℃	30℃	35℃	40℃
가사시간	6시간	4시간	2시간	1.5시간	1시간	0.5시간

#### 3) 도료의 희석

- AIRLESS SPRAY
  - 작업조건에 따라 희석제 #0910을 부피비 최대 10% 이내로 희석 사용 가능합니다.
- 붓 혹은 로라 도장
  - 부분 보수도장(터치업)을 위하여 붓 또는 로라로 작업이 가능하며, 작업조건에 따라 희석제 #0910을 부피비 최대 5% 이내로 희석 사용 가능합니다.

#### 4. 도장 방법

##### 1) 도장기기

- AIRLESS SPRAY기기  
 노즐구경 : 0.78~0.88mm (0.031~0.035")  
 분사압력 : 150~160Kg (2,200~2,400 P.S.I)
- 붓 또는 로라 도장  
 붓 또는 로라 도장 시 도막이 SPRAY 도장보다 적게 형성되므로 규정한 도막을 형성하기 위하여 도장횟수를 증가시켜야 합니다.  
 도장횟수를 줄이기 위하여 희석률을 낮출 경우 도막의 외관 불량 요인이 됩니다.  
 ※ 시험도장 : 수직면의 피도면에 시험 도장하여 본 도료의 특성 파악, 도막의 외관 상태 등을 사전 점검 후 본 도장을 하시기 바랍니다.
- 본 도장 시 규정도막두께는 130~150 마이크론이며, 최대 200 마이크론까지 도장이 가능합니다.
- 규정한 도막두께로 도장하기 위하여 WET FILM GAUGE를 이용하여 습도막을 측정하여 주십시오.

##### 2) 건조시간

(건조도막 150 마이크론 기준)

온도 기준		10℃	15℃	25℃	30℃
재도장 간격	최소	1일	16시간	9시간	5시간
	최대	15일	7일	5일	4일

##### ※ 참고사항

1. 상기 DATA는 습도 및 환기 조건, 도막 두께 등에 따라 변할 수도 있습니다.
2. 25℃ 에서 지촉건조는 약 3 시간 소요, 취급은 도장 후 7시간 경과 후 가능합니다.
3. 건조도막두께 검사는 상기 재 도장 가능시간을 기준으로 합니다.
4. 최대 재도장 간격이 경과 후 후속도장이 필요한 경우 구도막을 거칠게 해서 도장해야만 양호한 부착력을 얻을 수 있습니다.

##### 3) 후속도장

- 매우 작은 핀홀이나 표면의 미세한 부분은 세뉴폰 4360 으로 터치업 도장 후 고화건조가 되면 후속도장을 실시하여 주십시오.
- 붓 또는 로라 도장 시 도막두께 유지 또는 은폐력 향상을 위한 재 도장 시는 가능하면 1차 도장 후 10분(25℃기준)이내 도장하여 주시기 바랍니다.
- 최대 재 도장 간격 경과 시 표면의 먼지를 희석제 #001 로 표면처리 한 후 후속도장을 하시기 바랍니다.